

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

448

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

17.04.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	254		2	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3	
A-RS-FR4-ML-0.30mm-018+018-TG150-HF	50200785	18	L2	4	
		300			
		18	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	254		5	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		6	
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	7	

Dicke nach Verpressen

B00:

890 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

990 µm

Dmin:

790 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1000 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

1100 µm

Dmin:

900 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

880 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik